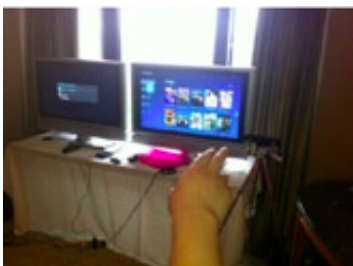


## Computex2013 新岸线通信计算一体化产品强势出击



台北时间2013年6月4日，台北国际计算机展Computex2013盛大开幕。全球领先的半导体芯片及软件技术方案提供商，大陆唯一具有自主研发的通讯与计算能力的芯片设计公司新岸线(Nufront)，携其全系芯片、3D手势识别体感方案CubeSense、多款手机解决方案强势出击、3G全功能通话平板，给参会者带来了无限惊喜与想象。

在新岸线的展位现场，最吸引业内技术人员的莫过于其最新发布的低功耗工艺的AP+BP方案的单芯片，四核Telink7689。Telink7689采用Cortex异构四核架构，主要支持3G语音与数据功能的平板计算机和大屏智能手机市场。

据现场工作人员介绍：Telink7689创新性的采用Cortex异构低功耗高性能四核CPU架构，支持下行HSPA+14.4Mbps和上行5.76Mbps。该设计迎合了未来主流高端平板和智能手机采用1080P高清显示屏以及1300万像素的双镜头等方面的需求；此外，它还支持丰富的外设接口。

展会上，新岸线还展出了最新的3D手势识别体感芯片CubeSenseTM以及基于该芯片的3D体感操控方案。该芯片是由新岸线自主设计研发并具备全部专利的高精度的深度感应芯片CubeSenseTM，基于人类双目视觉的立体成像原理，突破性地仅采用两颗普通的镜头就实现对3D空间中人体手势的感知。其最大特点就是让人类摆脱传统遥控器，利用人体3D手势实现对电视等智能终端进行的远程操控。该方案全面支持Android系统。

多屏互动下的移动互联是未来行业发展的趋势，而有着敏锐触觉的新岸线在此次展会上同时展出了基于NS115M和Telink7619的新岸线大屏智慧手机解决方案，结合新岸线低功耗控制的技术优势，将为未来市场的提供最为核心的竞争优势。

NS115M芯片采用ARMv7 Cortex-A9双核架构，拥有高达1.5GHz的主频与512KB二级缓存，采用先进的40nm制程工艺，内置基于目前市场上最先进的异构双核GPU架构的Mali-400MP图形处理芯片，支持OpenGL ES 2.0、OpenGL ES 1.1和OpenVG 1.1规范。除此之外还支援32位的LPDDR2/DDR3内存，1080P高清视频解码以及硬解Flash。跟之前的第三代NS115相比，芯片封装更小，功耗更低。

新岸线的双模通讯芯片Telink7619，具有语音、短信和高速数据业务等功能，支持HSPA+高达14.4兆高速的下行速率，可以为用户提供经济型高速互联网接入和无线资料等业务，用更低的功耗让用户畅享极速的流畅体验。

除此之外，基于NS115和Telink7619 3G模块的多款平板计算机方案也在展会上同时亮相，产品方案的超高性价比为新岸线带来更多的机会。

新岸线作为大陆最早进行通讯计算一体化布局的企业，此次带来的全线产品预示着新岸线的整体产品布局已经基本成熟，通讯方面的技术布局，将会为新岸线在进入竞争更为激烈的手机市场提供更为坚实的基础与优势，期待未来即将上市的新岸线四核AP+BP单芯片Telink7689在市场上的表现以及为我们带来更高性价比的芯片方案。